



# 2022年3月期 決算説明

1. 当期連結決算においては、連結子会社は2021年1月～2021年12月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、2022年3月期決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は開示日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

# 連結決算サマリー

(百万円)	2021年3月期	2022年3月期	前期比	
	金額	金額	金額	増減率(%)
売上高	91,312	133,821	42,509	46.6
売上原価	60,530	85,143	24,613	40.7
売上総利益	30,782	48,677	17,895	58.1
販売管理費	21,141	26,076	4,935	23.3
営業利益	9,640	22,600	12,960	134.4
営業外収益	1,609	4,636	3,027	188.1
営業外費用	3,022	1,243	△ 1,779	△ 58.9
経常利益	8,227	25,994	17,767	216.0
特別利益	5,544	9,421	3,877	69.9
特別損失	2,483	1,767	△ 716	△ 28.8
非支配株主に帰属する 当期純損益	△ 332	1,254	1,586	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	8,280	26,659	18,379	222.0
設備投資額	14,175	33,585	19,410	136.9
減価償却費	9,155	8,085	△ 1,070	△ 11.7

売上高1,338億円、前期比+46.6%

営業利益226億円、前期比+134.4%

- ・半導体関連需要が拡大、積極的に能力増強してきた半導体マテリアル、金属加工、パワ―半導体基板の新工場等がフル稼働
- ・2021/3期4Qからウエーハ加工を非連結化（売上高減少・営業利益増加要因）

経常利益260億円、前期比+215.9%

当期純利益267億円、前期比+221.9%

- ・中国ウエーハ3社第三者割当増資による持分変動利益93億円計上（前期も52億円計上）  
⇒ 為替差益25億円と合わせ118億円押上げ
- ・特別損失は、韓国FTAК撤退損9億円、洗濯機事業減損4億円

注 為替レート2021/3月期→2022/3月期：米ドル 106.43円→110.37円 人民元 15.42円→ 17.12円（期中平均レート）

Copyright © Ferrotec Holdings Corporation. All Rights Reserved.

# セグメント別売上高および営業利益

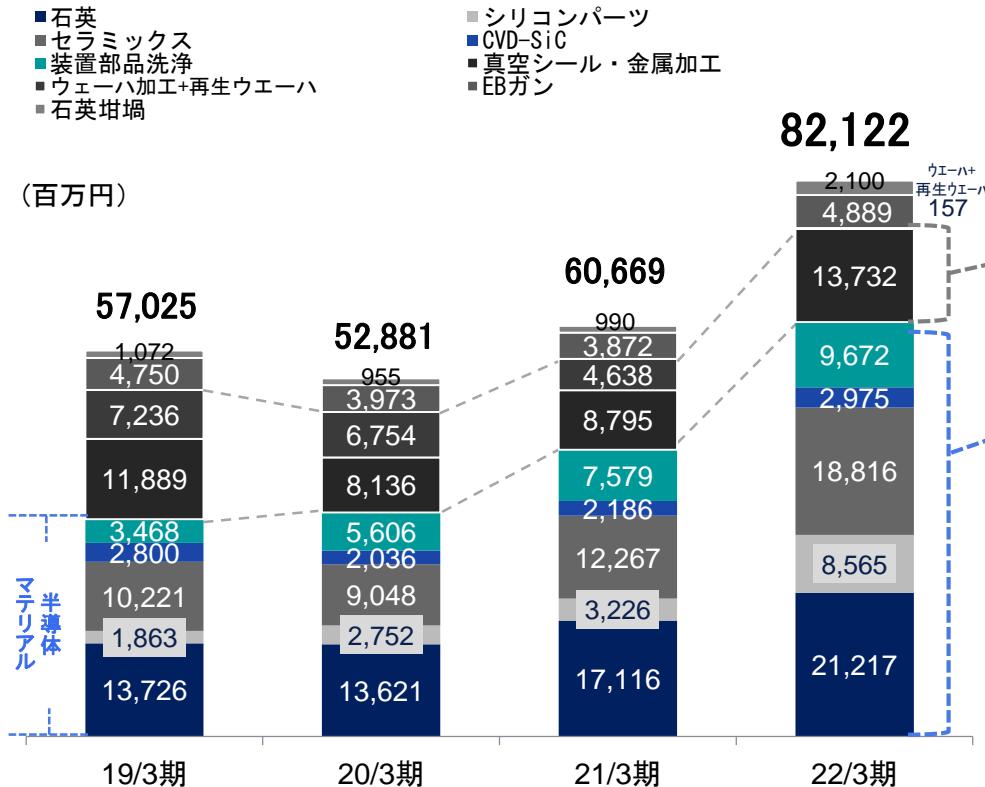
売上高 (単位:百万円)	2021年3月期		2022年3月期		前期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	60,669	66.4	82,122	61.4	21,453	35.4
電 子 デ バ イ ス	17,273	18.9	27,023	20.2	9,750	56.4
そ の 他	13,370	14.6	24,674	18.4	11,304	84.5
合 計	91,312	100.0	133,821	100.0	42,509	46.6

営業利益 (単位:百万円)	2021年3月期		2022年3月期		前期比	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	6,183	10.2	15,886	19.3	9,703	156.9
電 子 デ バ イ ス	4,453	25.8	6,689	24.8	2,236	50.2
そ の 他	△321	-	315	1.3	636	-
全 社 消 去	△674	-	△291	-	383	-
合 計	9,640	10.6	22,600	16.9	12,960	134.4

# 製品別売上高詳細

(百万円)		2021年3月期	2022年3月期	増減率
半	導 体 等 装 置 関 連	60,669	82,122	35.4
	真空シール・金属加工	8,795	13,732	56.1
マ テ リ ア ル	石英製品	17,116	21,217	24.0
	シリコンパーツ	3,226	8,565	165.5
	セラミックス	12,267	18,816	53.4
	CVD-SiC	2,186	2,975	36.1
	EBガン・LED蒸着装置	3,872	4,889	26.3
	ウエーハ加工	4,638	59	△ 98.7
	再生ウエーハ	0	98	-
	装置部品洗浄	7,579	9,672	27.6
	石英坩堝	990	2,100	112.1
電	子 デ バ イ ス	17,273	27,023	56.4
	サーモモジュール	13,036	17,635	35.3
	パワー半導体基板	3,491	8,473	142.7
	磁性流体・その他	746	916	22.8
そ	の	13,370	24,674	84.5
合	計	91,312	133,821	46.6

## 売上高の推移



## セグメント総括

半導体関連需要が拡大し、積極的に能力増強してきた半導体マテリアル及び金属加工の新工場が短期間でフル稼働、業績貢献  
前期比+35%

## 真空シール・金属加工、ウェーハ加工

【真空シール・金属加工】半導体製造装置メーカーからの金属加工受託事業の需要が拡大、常山新工場がフル稼働し、前期比+56%

【ウェーハ加工】21/1/3期4Qより持分法適用・非連結化により減収

## 半導体マテリアル、洗浄事業

【半導体マテリアル  
(石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC)】

半導体マテリアル需要が拡大、新工場のフル稼働が売上貢献、供給が追いつかず能力増強を継続、前期比+48.2%

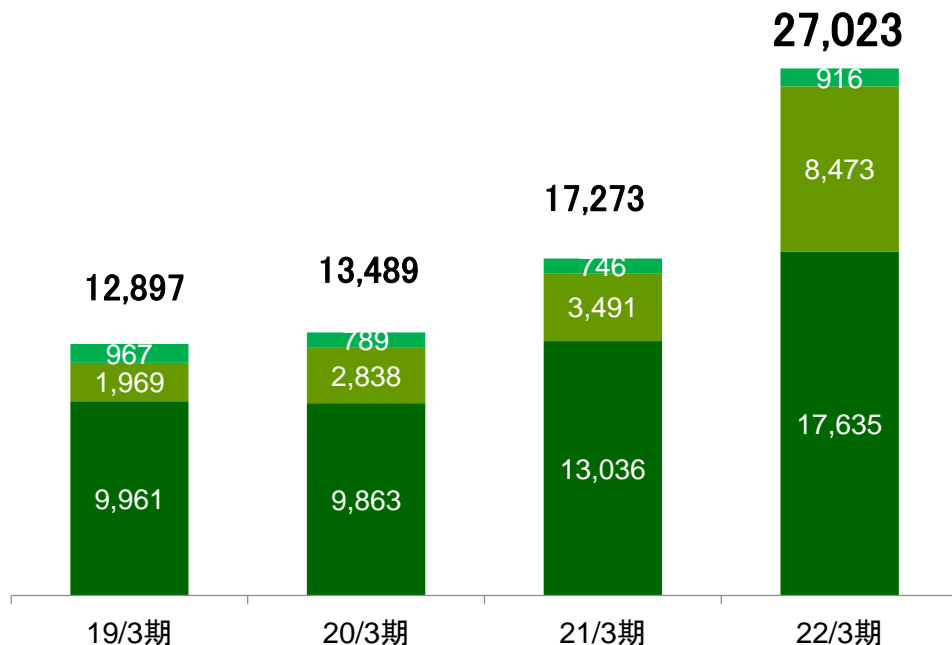
- 石英: 常山工場、東台工場がフル稼働が貢献
- シリコンパーツ: 銀川新工場を22/3期早急に立上げ・フル稼働
- セラミックス: ファインセラミックス杭州工場の能力増強・フル稼働、プローブカード向けも需要増加
- CVD-SiC: 中国顧客の需要が好調、岡山工場フル稼働

【洗浄事業】中国の半導体メーカー、FPDメーカーの生産拡大に伴う需要拡大に伴い好調、前期比+27.6%

## 売上高の推移

■サーモモジュール ■パワー半導体基板 ■磁性流体、他

(百万円)



## セグメント総括

・サーモモジュールの売上拡大、パワー半導体基板の売上急伸、前期比56.4%の大幅増収

### 【サーモモジュール】

・5G通信機器向け、およびPCR検査機など医療分野の伸長が著しく、前期比 35.3%の大幅増収

### 【パワー半導体基板】

・パワーデバイス市場が拡大、中国東台工場の産業機器・民生品向けDCB基板生産能力増強が寄与し、売上急拡大

・EV向けAMB基板の顧客認定が進捗

・前期比+143%

# 連結貸借対照表 ～資産～

(百万円)	2021/3期 期末	2022/3期 期末	増減額
流動資産	88,024	133,414	45,390
現金及び預金	30,202	52,579	22,377
受取手形及び売掛金	32,201	—	—
受取手形、売掛金及び契約資産	—	41,797	—
たな卸資産	17,072	28,436	11,364
固定資産	89,367	131,358	41,991
有形固定資産	53,146	84,083	30,937
建物及び構築物	15,446	22,728	7,282
機械装置及び運搬具	15,067	25,122	10,055
工具、器具及び備品	4,693	5,324	631
土地	1,893	1,895	2
リース資産(純額)	3,324	4,040	716
建設仮勘定	12,720	24,972	12,252
無形固定資産	1,966	1,996	30
のれん	340	283	△ 57
投資その他資産	34,254	45,277	11,023
資産合計	177,392	264,772	87,380

## 【流動資産の主な増加要因】

- ・現預金の増加は、子会社の第三者割当増資資金の滞留等(投資に充当予定)の要因あり
- ・売上増加により売上債権、棚卸資産の増加

## 【有形固定資産の主な増加要因等】

- ・中国・銅陵の再生ウエーハの設備投資
- ・銀川シリコンパーツ/坩堝事業の設備投資
- ・東台石英事業の設備投資
- ・東台パワー半導体基板事業の設備投資
- ・常山の金属加工等の設備投資
- ・銅陵再生ウエーハの設備投資

## 【投資その他資産の主な増加要因等】

- ・ウエーハ会社株式の計上金額が第三者割当増資(3元/株)により増加する等から、関係会社株式が127億円増加(2022/3期末のウエーハ会社株式の計上額275億円)

# 連結貸借対照表 ～負債及び純資産～

(百万円)	2021/3期 期末	2022/3期 期末	増減額
流 動 負 債	58,978	68,800	9,822
支払手形及び買掛金	20,012	26,702	6,690
短期借入金	5,426	6,324	898
1年内返済長期借入金 +1年内償還社債	11,981	8,501	△ 3,480
固 定 負 債	40,174	35,014	△ 5,160
社債	11,464	8,806	△ 2,658
転換社債型新株予約権付社債	3,734	2,134	△ 1,600
長期借入金	15,023	11,796	△ 3,227
負 債 合 計	99,152	103,814	4,662
純 資 産	78,239	160,957	82,718
株主資本	63,408	117,511	54,103
その他の包括利益累計額	3,684	13,511	9,827
非支配株主持分	11,064	29,888	18,824
負 債 ・ 純 資 産 合 計	177,392	264,772	87,380
自 己 資 本 比 率	37.8%	49.5%	11.7pt

## 【流動負債、固定負債の主な変動要因等】( )内は2021/3期末比

短期借入+1年内長借・社債	14,825百万円	(△2,582)
長期借入+社債・転換社債	22,736百万円	(△7,485)
有利子負債 合計	37,561百万円	(△10,067)

## 【純資産の主な変動要因等】( )内は2021/3末比

- ・資本剰余金 46,071百万円(+18,500)  
当社、ウエーハ会社、中国子会社の第三者割当増資による
- ・利益剰余金 43,317百万円(+25,096)
- ・為替換算調整勘定 13,128百万円(+9,672)  
円安進行に伴い増加
- ・非支配株主持分  
中国のFTSJ(DCB)、AQM-N(シリコンパーツ・坩堝)、FTASM  
(再生ウエーハ)への第三者割当増資による増加

## 【自己資本比率】

自己資本比率は49.5%と、中計の目標値40%を超過

注 為替レート2021/3月期→2022/3月期：米ドル 103.50円→115.02円 人民元 15.88円→ 18.06円(期中平均レート)



# キャッシュフロー計算書

(百万円)	2021/3期	2022/3期
営業活動によるキャッシュフロー	13,217	17,833
税金等調整前四半期純利益	11,288	33,648
減価償却費	9,155	8,085
為替差損益(△:益)	△ 90	△ 2,026
売上債権の増減(△:増加)	△ 13,768	△ 4,258
棚卸資産の増減(△:増加)	△ 3,324	△ 9,126
仕入債務の増減(△:減少)	7,726	6,065
持分変動損益(△:益)	△ 5,284	△ 9,327
その他	7,514	△ 5,228
投資活動によるキャッシュフロー	△ 20,879	△ 29,399
有形固定資産取得による支出	△ 14,175	△ 33,585
有形固定資産の売却による収入	798	400
無形固定資産の取得による支出	△ 121	△ 241
関係会社株式の取得による支出	△ 6,852	△ 1,278
その他	△ 529	5,305
財務活動によるキャッシュフロー	21,694	30,601
短期借入金の増減額	△ 5,856	180
長期借入れによる収入	16,601	2,545
長期借入金の返済による支出	△ 28,332	△ 6,944
株式の発行による収入	76	19,275
非支配株主からの払込みによる収入	15,149	22,701
その他	24,056	△ 7,156
現金及び現金同等物の増加額	14,207	22,376
現金及び現金同等物の期首残高	23,709	30,202
現金及び現金同等物の期末残高	30,202	52,579

## 【営業CFの状況】

・税前利益+減価償却費	41,733百万円
・売上債権・棚卸・仕入債務増減	△7,319百万円

## 【投資CFの状況】

有形・無形固定資産の取得: (主には中国における設備投資による)	△33,826百万円
-------------------------------------	------------

## 【財務CFの状況】

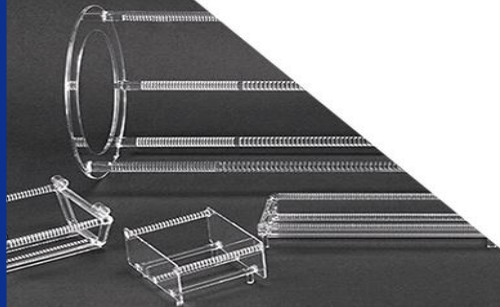
非支配株主からの払込みによる収入:	22,701百万円
・増埜・シリコンパーツ子会社	9,146百万円
・中国パワー半導体子会社(FTSJ)	8,307百万円
・再生ウエーハ(FTASM)	4,733百万円



**FerroTec**  
Ferrotec Holdings Corporation



## 2023年3月期 通期業績予想



- ・ 売上高、各利益ともに大幅な増収増益、過去最高値を更に更新の見込み
- ・ 顧客からの増産要請は強く、建設中の工場の稼働本格化も見込む

(百万円)	2022/3期	2023/3期(計)	前期比 (%)	計画の詳細・前提
売上高	133,821	<b>180,000</b>	<b>34.5</b>	半導体顧客の増産要請に対応し、積極的な増産投資を継続中、能力増強により増収を見込む
営業利益	22,600	<b>30,000</b>	<b>32.7</b>	設備増強・新工場立上げを早期に実現することで、大幅増益を見込む
経常利益	25,994	<b>28,000</b>	<b>7.7</b>	22/3期計上した為替差益2,542百万円を見込まない前提で、増益を見込む
親会社に帰属する 当期純利益	26,659	<b>17,000</b>	<b>△ 36.2</b>	22/3期9,327百万円計上した持分変動利益を見込まない前提で、前期比減
減価償却費	8,085	<b>13,297</b>	<b>64.5</b>	半導体マテリアル製品の設備増強等により増加
EBITDA	30,685	<b>43,297</b>	<b>41.1</b>	-

注 為替レート2022/3期→2023/3期 予想レート：米ドル円110.37→117.79円 人民元 17.12円→18.56円(期中平均レート)

\*EBITDA=営業利益+減価償却費にて計算、連結子会社の外部出資に相当する損益は、非支配者株主損益に織込み

# 23/3期 セグメント・製品別の業績予想



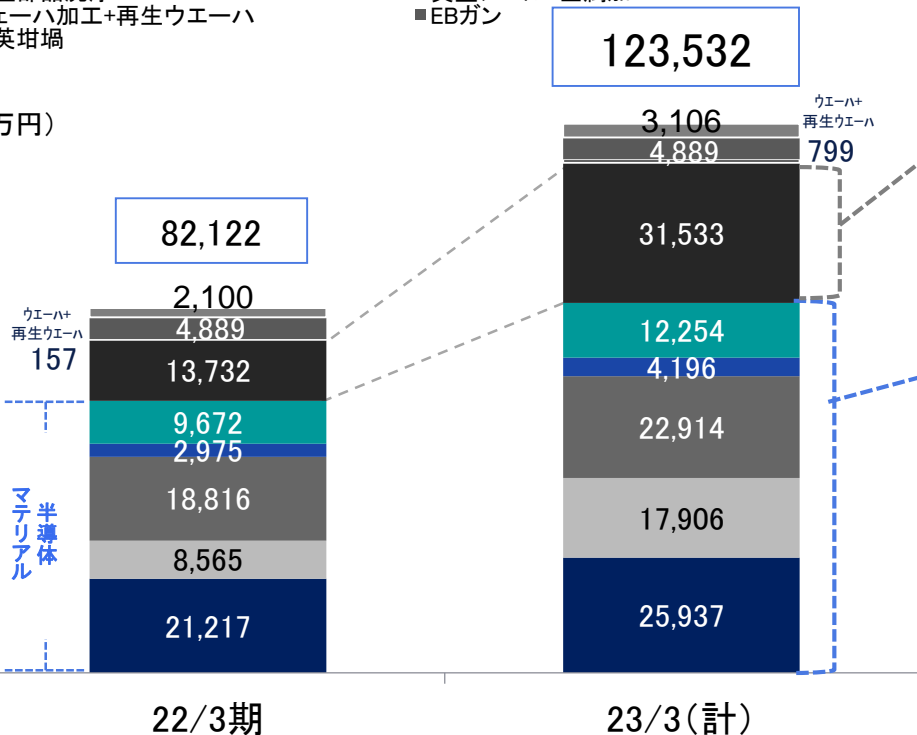
(百万円)	22/3期	23/3期(計)	YoY(増減率)
半 導 体 等 装 置 関 連	82,122	123,532	50.4
真空シール・金属加工	13,732	31,533	129.6
石英製品	21,217	25,937	22.2
シリコンパーツ	8,565	17,906	109.1
セラミックス	18,816	22,914	21.8
CVD-SiC	2,975	4,196	41.0
EBガン・LED蒸着装置	4,889	4,889	0.0
ウエーハ加工(連結対象外)	59	0	-
再生ウエーハ	98	799	715.3
装置部品洗浄	9,672	12,254	26.7
石英坩堝	2,100	3,106	47.9
電 子 デ バ イ ス	27,023	37,937	40.4
サーモモジュール	17,635	19,354	9.7
パワー半導体	8,473	17,142	102.3
磁性流体・その他	916	1,441	57.3
そ の 他	24,674	18,532	△ 24.9
合 計	133,821	180,000	34.5

## 売上高の推移

- 石英
- セラミックス
- 装置部品洗浄
- ウェーハ加工+再生ウェーハ
- 石英増埧

- シリコンパーツ
- CVD-SiC
- 真空シール・金属加工
- EBガン

(百万円)



## セグメント総括

- ・ 前期比+50.4%、前期に続き大幅な増収増益
- ・ 半導体関連顧客の増産要請に対応、設備増強を継続、生産能力拡大により売上拡大を見込む

## 真空シール・金属加工

- ・ 前期比+130%、金属加工において、常山工場の半導体製造装置向けチャンパー・ロボット部品等の金属受託加工が伸長見通し

## 半導体材料、洗浄事業

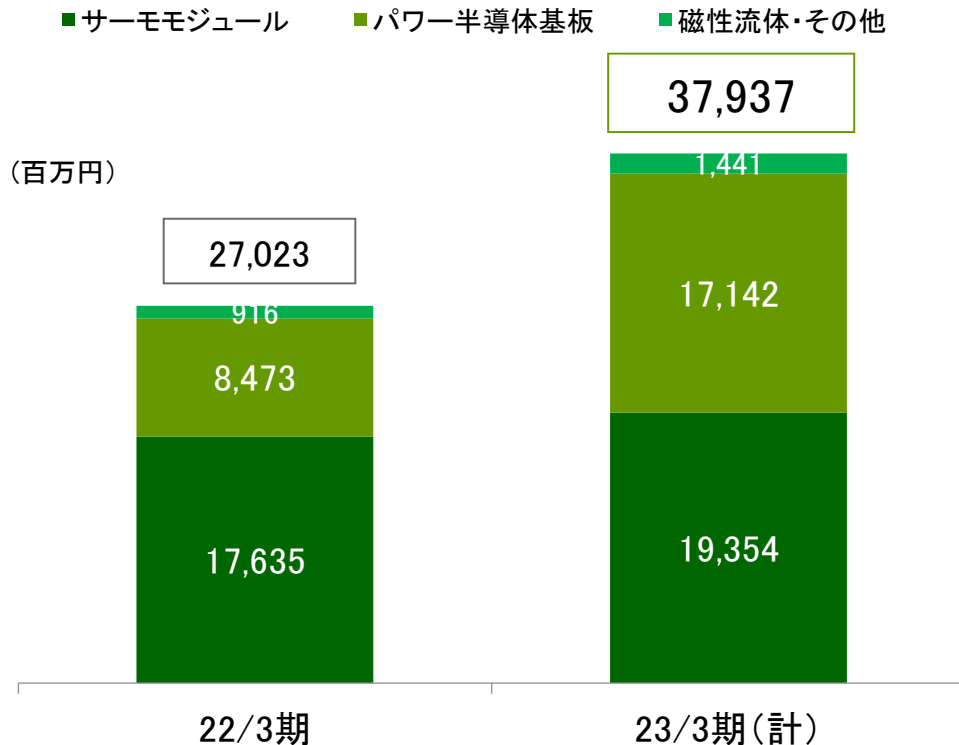
【半導体材料(石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC)】

- ・ 前期比+38%、半導体製造装置市場及び半導体デバイス市場の拡大を受け、半導体材料の需要拡大、増産要請に対応
- ・ 石英: 常山工場・東台工場の能力拡充を継続、売上増大
- ・ シリコンパーツ: 銀川工場の能力拡充により、売上伸長
- ・ セラミックス: 半導体製造向けは杭州工場の能力拡充を継続、プローブカード向けも需要増加
- ・ CVD-SiC: 顧客の増産要請に対応して岡山工場の能力拡充

【洗浄事業】

- ・ 需要が堅調に拡大、能力増強、広州工場を立上げ

## 売上高の推移



## セグメント総括

前期比+40.4%、前期に続き売上拡大  
パワー半導体基板の大幅な増収増益を見込む

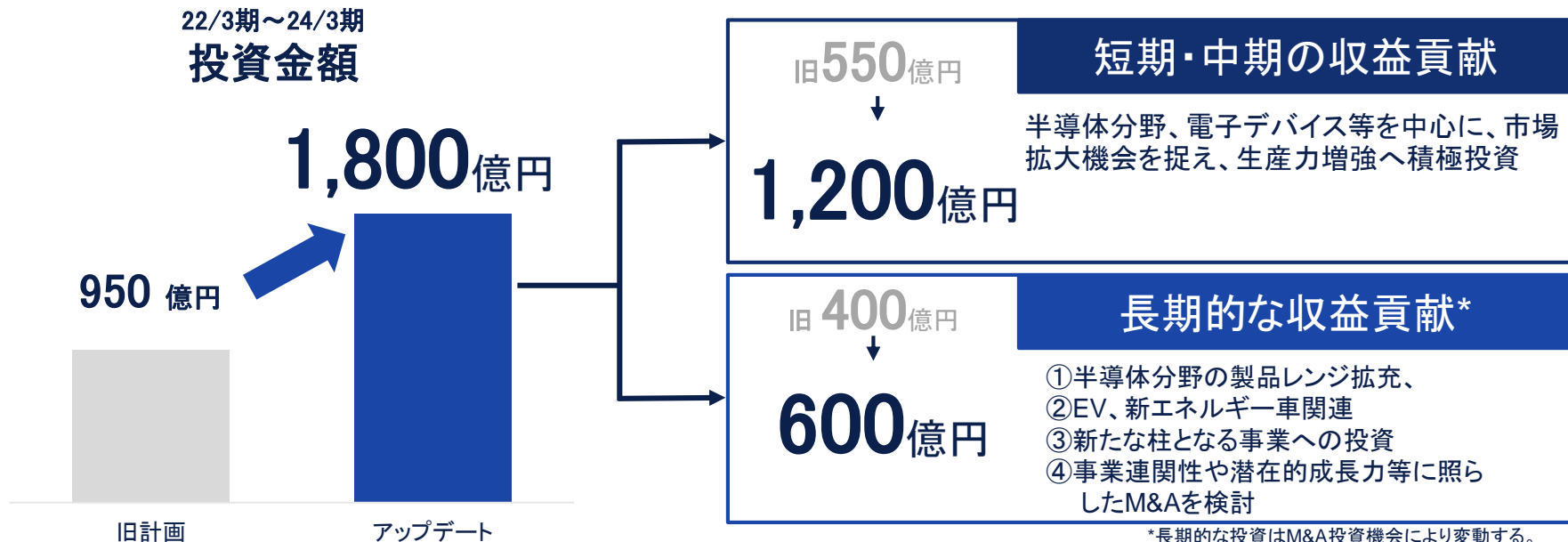
### 【サーモモジュール】

- 前期比+10%、5G通信機器向け、PCR検査機など医療分野、および家電民生品分野の需要が堅調

### 【パワー半導体基板】

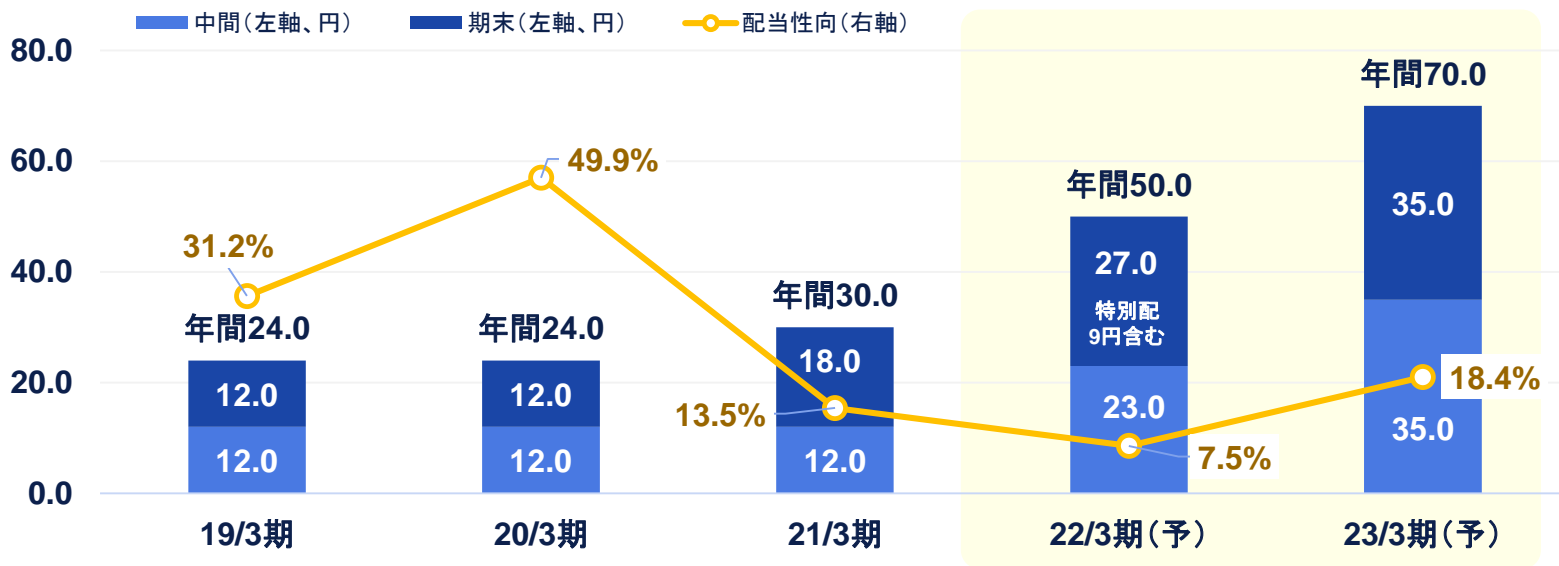
- 産業機器・民生品向DCB基板の需要拡大、生産能力の拡大継続と適合し、売上増大中
- 自動車・EV向けAMB基板の量産体制を確立、顧客認定取得も進展、急速な売上拡大及び業績貢献を見込む
- 前期比+102%の増加

- 3年間で総額950億円を予定した投資額を1,800億円へ増額(M&A検討分含む)
- 急速に成長する市場の需要を捉えつつ、持続的な成長力を確保するため、短期・中期だけでなく、長期的な成長に向けた戦略投資を積極的に実行



- 持続的な収益増強により株主還元を増加させてく基本方針は不変であるが、配当の決定に際して、配当性向20%を意識して、財務・投資機会等とのバランスを考慮して判断する
- 投資規模を勘案し、23/3期の1株当たり年間配当金は70円の予想(3期連続の増配を予定)

## 1株当たり配当金の推移





# 23/3期計画値 上期と下期-1 業績別

(百万円)	2023年3月期上期 計画		2023年3月期下期 計画			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
売上高	84,000	100.0	96,000	100.0	12,000	14.3
売上総利益	30,635	36.5	35,760	37.2	5,125	16.7
販売管理費	16,635	19.8	19,760	20.6	3,125	18.8
営業利益	14,000	16.7	16,000	16.7	2,000	14.3
経常利益	13,000	15.5	15,000	15.6	2,000	15.4
当期純利益	7,800	9.3	9,200	9.6	1,400	17.9

# 23/3期計画値 上期と下期-2 製品別

(百万円)	2023年3月期上期 計画		2023年3月期下期 計画			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	57,947	69.0	65,585	68.3	7,639	13.2
真空シール	14,526	17.3	17,007	17.7	2,481	17.1
石英製品	12,237	14.6	13,700	14.3	1,463	12.0
シリコンパーツ	8,406	10.0	9,500	9.9	1,094	13.0
セラミックス	11,114	13.2	11,800	12.3	686	6.2
CVD-SiC	1,976	2.4	2,220	2.3	244	12.3
EBガン・LED蒸着装置	2,390	2.8	2,499	2.6	109	4.6
再生ウエーハ	190	0.2	609	0.6	419	220.5
部品洗浄	5,554	6.6	6,700	7.0	1,146	20.6
石英坩堝	1,554	1.9	1,552	1.6	△ 2	△ 0.1
電 子 デ バ イ ス	17,445	20.8	20,492	21.3	3,047	17.5
サーモモジュール	9,640	11.5	9,714	10.1	74	0.8
パワー半導体基板	7,241	8.6	9,901	10.3	2,660	36.7
磁性流体・その他	564	0.7	877	0.9	313	55.5
そ の 他	8,609	10.2	9,923	10.3	1,315	15.3
合 計	84,000	100.0	96,000	100.0	12,000	14.3

注 ウエーハ加工については今期より連結対象外となるため記載を割愛

- 本資料に掲載されている業績見通しの数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、新型コロナウイルス、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額及び市況、為替レートなどが含まれますが、これに限定されるものではありません。
- 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。

<照会先>

IR室 03-3281-8186